

上海天承科技股份有限公司 关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信。

一、授信额度及期限

1、授信额度：公司及全资子公司拟申请的综合授信额度合计不超过人民币 100,000 万元（含本数）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求合理确定，并以最终与各金融机构实际签署的合同及发生的融资金额为准。

2、授信期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环滚动使用。

二、授信业务品种

本次申请的综合授信业务范围包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、贸易融资等（具体业务品种及使用条件以相关金融机构最终审批核准的结果为准）。

三、授权事宜

为提高融资决策效率，保障相关业务的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度及期限内，代表公司及全资子公司全权办理本次授信相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款以及公司以自有资产为自身债务设定的抵押/质押合同等）。如前述授信业务涉及公司为子公司提供担保，或资产抵质押金额达到相关审议标准的，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，另行履行相应的审批及信息披露程序。同时，授权公司经营管理层根据实际资金需求，具体办理上述授信项下的各项融资手续。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年4月28日